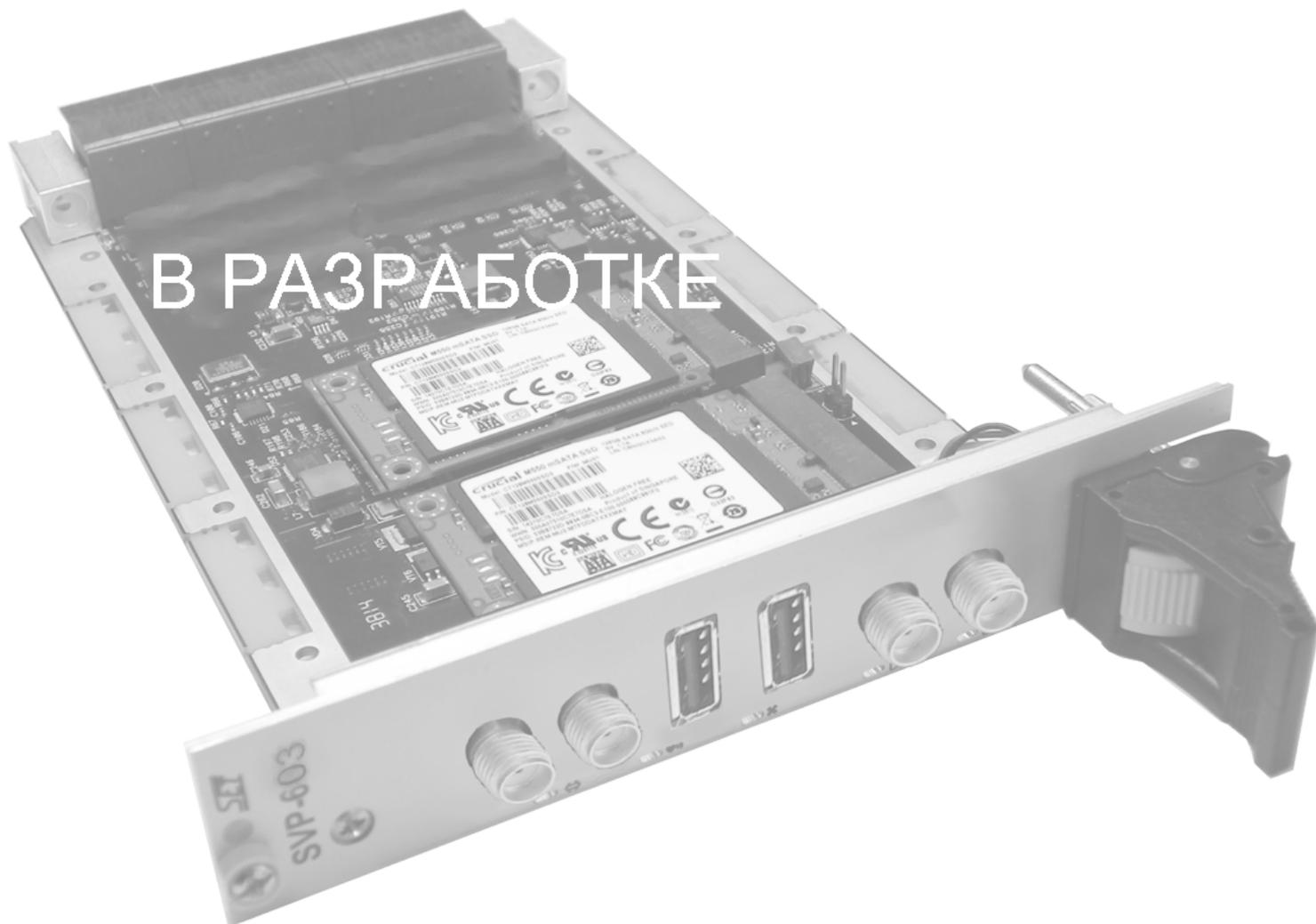


SVP-603

Несущий модуль с поддержкой субмодулей Mini PCIe форм-фактора VPX 3U



Основные особенности

- Два слота для установки Mini-SIM карт и двух разъемов SMA (опционально)
- Подключение по шине PCI Express 2.0 x4
- Модуль форм-фактора VPX 3U, соответствующий стандартам: ANSI/VITA 46.0-2013 (воздушное охлаждение), ANSI/VITA 46.4-2012, ANSI/VITA 46.6-2013, ANSI/VITA 46.9-2010, ANSI/VITA 48.2-2010 (кондуктивное охлаждение) и ANSI/VITA 65-2010 (R2012)
- Профиль слота модуля: MOD3-PER-2F-16.3.1-3
- Вывод двух или четырех USB 3.0 на переднюю панель
- Интегрированная интеллектуальная система контроля и управления IPMI v. 1.5

Обзор модуля

Особенности

Модуль SVP-603 — несущая плата для Mini-PCIe субмодулей, в форм-факторе VPX 3U с гибкими коммутационными возможностями и с широким диапазоном рабочих температур.

Конструктивное исполнение соответствует стандартам: ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard, ANSI/VITA 46.4-2012 PCI Express on the VPX Fabric Connector, ANSI/VITA 46.6-2013 Gigabit Ethernet Control Plane on VPX, ANSI/VITA 46.9-2010 PMC/XMC Rear I/O Fabric Signal Mapping on 3U and 6U VPX Modules Standard, ANSI/VITA 48.2-2010 Mechanical Specifications for Microcomputers Using RED! Conduction Cooling Applied to VITA VPX (кондуктивное охлаждение) и ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX System Standard. Подбор компонентов модуля и конструктивная реализация системы охлаждения позволили добиться расширенного рабочего температурного диапазона.

Набор интерфейсов соответствует профилю: MOD3-PER-2F-16.3.1-3.

Система IPMI v. 1.5 позволяет осуществлять удаленный мониторинг температур и напряжений питания, что снижает вероятность сбоя системы или выхода из строя оборудования.

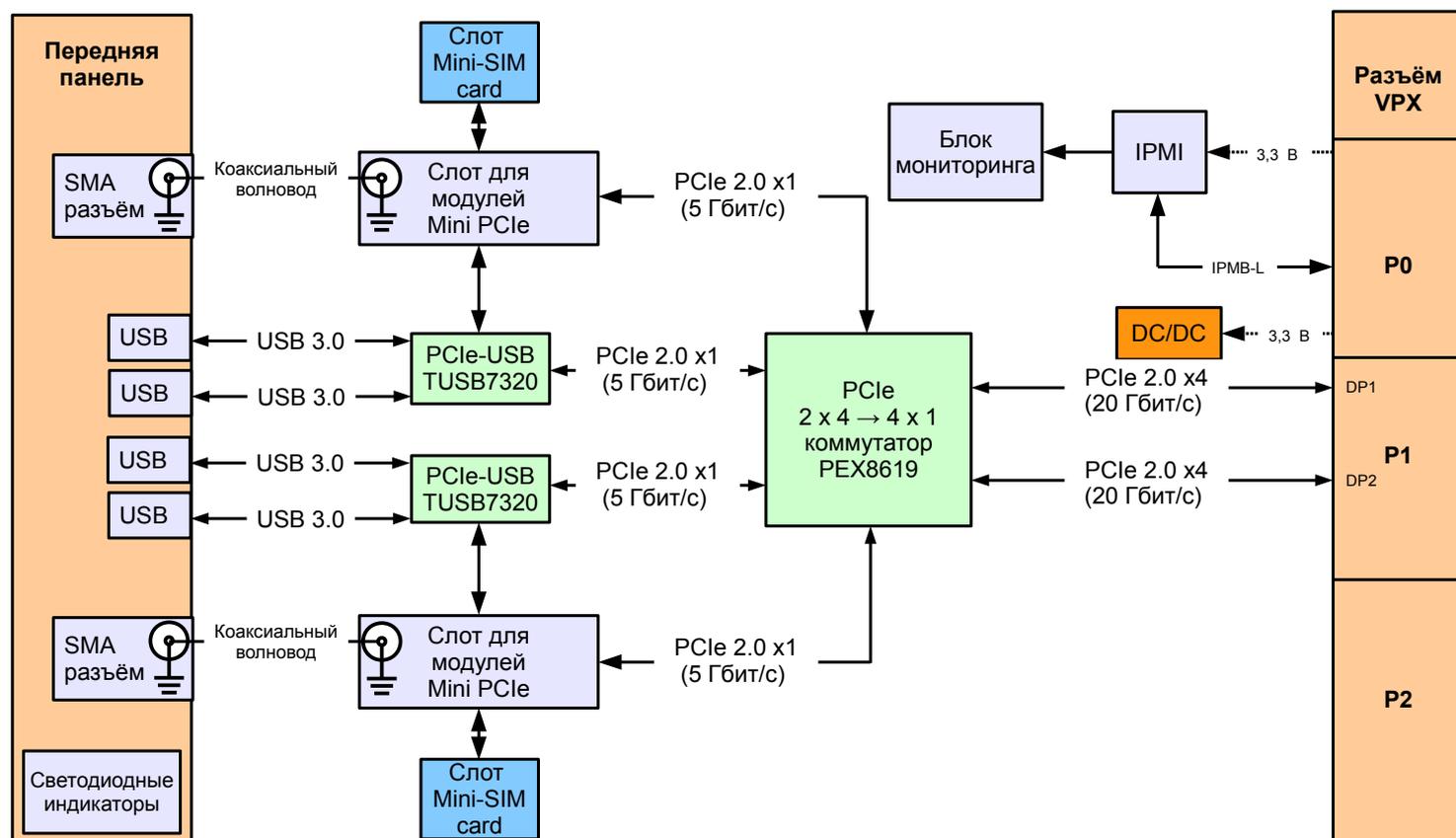
Совместимость с операционными системами (ОС)

Контроллеры интерфейсов и интегрированные устройства процессора не требуют написания специального программного обеспечения, все поставляемые драйверы совместимы с большинством ОС. Стандартная поставка модуля обеспечивает драйверную поддержку в следующих ОС: Microsoft Windows 7/8.1/10, Embedded Standard 7/8.1, Server 2008 R2 SP1/2012/2012 R2, QNX Neutrino RTOS 6.5.0/6.6.0, ЗОСРВ «Нейтрино» (КПДА.10964-01), Astra Linux Special Edition 1.3/1.4/1.5, Защищённая ОС «Заря», МСВС 3.0 ФЛИР.80001-16 изм. №3 и Linux (с версией ядра 3.2.0 и выше).

Области применения

Модуль SVP-603 разработан для применения в составе систем, требующих интеграции с беспроводными сетями передачи данных. Применение в любых системах, построенных на оборудовании стандартов VPX 3U, где требуется расширение функциональных возможностей за счет дополнительных субмодулей.

Функциональная блок-схема



Технические характеристики

Интерфейсные контроллеры

Коммутатор PLX8619 2x PCI Express x4 на:

- 2 × PCI Express x1 на 2 слота Mini-PCI Express;
- 2 × PCI Express x1 на USB контроллеры TUSB7320.

Два контроллера интерфейса USB 2.0/3.0 TUSB7320:

- 1 × USB 2.0 для слота Mini PCI Express;
- 4 × USB 3.0 на переднюю панель.

Субмодули

Поддержка установки субмодуля Mini-PCI Express: с поддержкой PCI Express 2.0 x1 и USB 2.0 (опция)

Возможность установки 2-х слотов для карт Mini-SIM

Система мониторинга и управления IPMI

Автоматическое отключение питания при возникновении серьезных сбоев на модуле

Мониторинг температур и напряжений питания модуля

Ведение журнала учета отказов блоков системы

Возможность удаленного контроля и управления модулем

Возможность «горячего» обновления и восстановления программного обеспечения IPMI без нарушения работы модуля

Информационная шина на разъеме VPX P0 для управления и мониторинга (IPMB-L)

Поддержка «горячей замены» (Hot Swap)

Соответствие стандартам

ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard

ANSI/VITA 46.4-2012 PCI Express on the VPX Fabric Connector

ANSI/VITA 46.6-2013 Gigabit Ethernet Control Plane on VPX

ANSI/VITA 46.9-2010 PMC/XMC Rear I/O Fabric Signal Mapping on 3U and 6U VPX Modules Standard

ANSI/VITA 48.2-2010 Mechanical Specifications for Microcomputers Using REDI Conduction Cooling Applied to VITA VPX (кондуктивное охлаждение)

ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX System Standard
Профиль модуля: MOD3-PER-2F-16.3.1-3

IPMI v. 1.5 с поддержкой служебных функций

Поддержка ОС

Microsoft Windows 7/8.1/10, Embedded Standard 7/8.1, Server 2008 R2 SP1/2012/2012 R2

QNX Neutrino RTOS 6.5.0/6.6.0

ЗОСРВ «Нейтрино» (КПДА.10964-01)

Astra Linux Special Edition 1.3/1.4/1.5

Защищённая ОС «Заря»

МСВС 3.0 ФЛИР.80001-16 изм. №3

Linux (с версией ядра 3.2.0 и выше)
(Поддержка других ОС уточняется отдельно)

Разъёмы VPX

Разъём P0

- 1 × IPMB-L.

Разъём P1

- 2 × PCI Express x4 (DP1–2, пластины 1–4).

Передняя панель

Два разъёма интерфейса USB 3.0, тип A

Отверстия для монтажа разъёмов SMA

Энергопотребление

Потребляемая мощность несущего модуля не более 23 Вт

Распределение потребляемой мощности по линиям питания:

- +12 В (VS1): до 1 А (12 Вт);
- +5 В (VS2): до 2 А (10 Вт);
- +3,3 В_AUX (VS3): до 0,1 А (0,33 Вт) (питание IPMI).

Условия эксплуатации

Охлаждение: воздушное или кондуктивное

Диапазон рабочих температур: коммерческий (0...+50 °C) или промышленный (-40...+85 °C)

Температура хранения: -50...+85 °C

Влажность: 10–95 % без конденсата

Возможность нанесения влагозащитного покрытия для жёстких условий

Размеры

Форм-фактор: VPX 3U

Размеры: 160 × 100 × 25,06 мм

Информация для заказа

**I**

Исполнение (температурный диапазон)

T0: Коммерческое (0...+50 °C)**T1:** Индустриальное (-40...+85 °C)**II**

Покрытие

CV0: Без влагозащитного покрытия**CV1:** С влагозащитным покрытием**III**

Охлаждение

CL0: Воздушное**CL1:** КондуктивноеПример кода изделия: **SVP-603-T1-CV1-CL1****SVP-603** — Несущий модуль с поддержкой submodule Mini PCIe форм-фактора VPX 3UИсполнение (температурный диапазон): *Индустриальное (-40...+85 °C)*Покрытие: *С влагозащитным покрытием*Охлаждение: *Кондуктивное*

Возможны другие конфигурации модуля по индивидуальному запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в SET.

Контактная информация



ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком»
Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 75
Тел.: +7 (473) 272-71-01, факс.: +7 (473) 251-21-99
www.setdsp.ru

Электронная почта:
Отдел продаж: sales@setdsp.ru

ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 3, корп. 1, лит. М.
Тел.: +7 (812) 406-99-95, +7 (812) 406-99-96
www.setdsp.ru

Электронная почта:
Отдел продаж: sales.spb@setdsp.ru